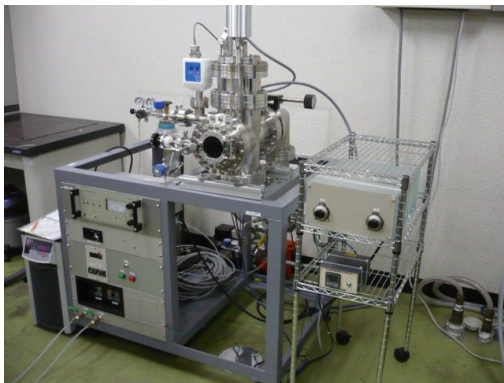


小型単元スパッター装置 (SPLD-210)

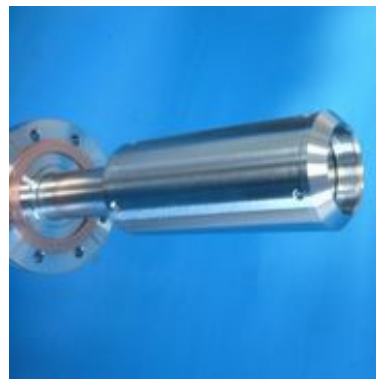
(Compact Sputtering System)

〔概要 : Outline〕

本スパッター装置は小型で容易な操作ながら高品質のスパッタ薄膜が得られるコストパフォーマンスに優れた装置です。
又、豊富なオプションにより金属、半導体、絶縁物、磁性体等幅広い材料の薄膜が得られます。



〔SPLD - 210〕



〔2"スパッタガン〕

〔特徴:Feature〕

- 1) 小型軽量なため、取り扱いが容易であると共に排気が早く、スパッタ成膜迄短時間で到達します。
- 2) 磁場に工夫を加えたスパッタガンにより磁性材料にも対応可能です。
- 3) 低価格、省スペースでコストパフォーマンスに優れています。

構成	主な仕様	備考
チェンバー及び 排気系	<ul style="list-style-type: none"> ・チェンバー：φ200×400 SUS304 ・主ポンプ：70ℓ/s ターボ分子ポンプ ・到達圧力：5×10⁻⁵Pa ・ゲージ：ピラニゲージ及びペニングゲージ ・ポート：排気、スパッタガン1基、(1"スパッタガンの場合3基可能) 基板交換用ハッチ ・操作：手動 	
スパッタ源	<ul style="list-style-type: none"> ・2"スパッタガン ・300W DC 電源 (パワー設定可能) 或はマッチングボックス付 300W RF 電源 	個別カタログ参照下さい。 冷却水2ℓ/min.以上
基板ステージ	<ul style="list-style-type: none"> ・収納基板：最大φ2" ・300℃或は800℃加熱機構 (オプション) 	
ガス導入機構	10SCCM マスフローコントローラー	

尚、予告なく性能向上のため仕様変更することがあります。

PVR(Professional Vacuum Research)

真空機器技術コンサルティング

開発・製造・販売

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-26-2

TEL・FAX：027-226-5491

URL：http://www.pvr-ishida.com/

E-mail：tetsuomaebashi@yahoo.co.jp